

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥



## 甘肃上峰水泥股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国泰海通：鲍雁辛、花健祎； 申万菱信基金：刘毅男。
时间	2026年3月27日
地点	杭州市文二西路738号西溪乐谷创意产业园
上市公司参会接待人员姓名	董事长兼总裁：俞锋； 党委书记、董事、副总裁兼董秘：瞿辉； 董事长助理：王洁洁。
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、公司战略落地发展情况简述</b> 2019年公司制定并发布五年规划起，董事会明确了立足建材主业谋求转型升级发展的方向路径，并通过对新兴产业股权投资稳健布局和资源积累，逐渐明晰第二成长曲线业务的发展方向。 六年来，公司在建材基石业务方面保持了领先的成本效率竞争力，连续保持净资产收益率行业领先，毛利率连续5年保持行业上市公司首位；股权投资业务聚焦半导体产业链先后布局了合肥晶合、长鑫存储、广州粤芯、盛合晶微、鑫华半导体、鑫丰科技等科创企业，超60%投资额的标的企业已启动上市或已上市发行，同时在半导体产业链积累了深

厚资源。

2025 年公司发布的新五年规划中进一步明确了“三驾马车”独特业务格局：水泥建材基石业务，股权投资资本业务，新质材料成长业务。公司致力于三个业务齐头并进稳健发展与成长。具体三个业务情况：

#### **（一）建材基石业务绩效-“人有我优”**

公司建材业务绩效与同行业上市公司相比继续保持明显的优质水平：在规模并不占优的情况下，公司近五年的销售毛利率和平均净资产收益率、人均营业利润、总资产报酬率等始终保持水泥行业上市公司领先，一方面体现了上峰水泥专业化的运营管理能力，在周期波动中保持了极强的韧性；一方面基于上峰水泥独特不可复制的壁垒优势：在物流条件极佳的市场区域布局优势、充足矿山资源储备、高效率与规范稳健结合的混合所有制机制优势，由此筑牢了高盈利能力的持续稳固。

公司长期稳定优质的业绩与现金流为股东创造了良好回报，在实施分红方面：2013 年公司以重组形式上市，未向市场募资，自此以来公司在未向资本市场融资情况下已实施了 11 次的权益分派方案，累计分红金额 38.19 亿元（含回购）；2024 年，公司每 10 股派发现金红利 6.30 元（含税），合计派发现金红利 6 亿元（含税），占本年度归母净利润（合并报表）的 95.73%。

#### **（二）股权投资稳健优质-“人无我有”**

公司股权投资以培育积累第二成长曲线业务生态资源为导向，聚焦半导体、新材料领域等战略新兴产业，围绕国家重点支持倡导的核心技术科技创新领域，经过多年精心布局，公司先后投资了晶合集成、广州粤芯、长鑫存储、先导电科、昂瑞微、中润光能、上海超硅、盛合晶微、芯耀辉、壹能科技、鑫华半导体、西安奕材、鑫丰科技等多家优质企业，覆盖“设计-制造-封测-材料”的半导体全产业链，截止 2026 年 2 月，公司新经济股权投资累计规模 20.65 亿元，合计 29 个项目，其中，已经发行上市的项目 3 个、上市已受理项目 8 个、上市公司并购项目 2 个、辅导备案项目 3 个、回购或转让项目 4 个。按照战略规划总体股权投资总规模计划目标约 30 亿元，各年度严控额度，严控风险，每年保持约

3~5 亿元资金继续投资于国家鼓励的科创新经济产业股权。

### **（三）新质材料业务情况一加快培育**

公司于 2026 年 3 月 16 日与深圳志金在杭州签署战略合作协议，公司通过控股子公司收购及增资控股深圳市志金电子有限公司（以下简称“深圳志金”）持有的美琪电路（江门）有限公司（以下简称“美琪电路”），交易完成后，公司将合计持有美琪电路 75%的股权，公司由此正式进入半导体封装基板业务。

### **（四）美琪电路基本情况简述**

#### **1、美琪电路主营业务**

美琪电路专业生产半导体封装基板，主要业务模式是向供应商采购金盐、覆铜板、干膜、油墨、化学药剂、铜箔、半固化片等原材料完成 IC 封装基板的制造。

#### **2、所处行业**

IC 封装基板（IC Package Substrate）是连接裸芯片（DIE）与印刷电路板（PCB）的信号载体，承担信号传输、芯片支撑、散热保护三大核心功能，处于半导体芯片产业链中封装环节。国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“刚挠印刷电路板及封装基板”被列为鼓励类产业。

3、美琪电路目前营业收入和总资产占公司营业收入和总资产的比例不足 1%，占比较小，短期对公司业务规模及财务情况影响较小。但美琪电路的封装基板业务与公司战略发展第二成长曲线业务方向契合，与股权投资的半导体产业链资源积累相匹配，公司可以为美琪电路提供稳定的资金资本支持及半导体产业链渠道资源赋能，并以高效规范的精益管理体系助力新业务的竞争力提升及规模实力的成长壮大。

### **（五）战略规划落地推进**

公司将按照董事会制定发布的五年规划指引，落实推进“三驾马车”保持稳健发展。

建材基石业务以做“优”为本，精耕细作，降本增效，保持领先的市场竞争力，为半导体封装基板等新质业务壮大发展提供稳定的现金流

	<p>投入保障；股权投资业务以做“稳”为先，严控额度、严控风险，继续聚焦国家重点鼓励的新兴支柱产业，适度布局国家倡导支持的未来科技产业，保持战略规划目标总额度与资产比重；以封装基板为切入口的半导体封装材料业务当前以做“快”为主，加大投入，搭建高标准的专业运营管理与研发团队，快速提升新质业务实力规模与综合竞争力。</p> <p>公司将全力推动“三驾马车”协同协调发展，保持稳固增长发展的总体格局。</p> <p><b>二、提问环节</b></p> <p><b>（一）请问公司为什么选择美琪电路，而不是选择更大规模或更成熟的项目？</b></p> <p>答：深圳志金成立于2005年，美琪电路是其2020年在江门新投资生产线主体，本次与深圳志金合作，其将所有的封装基板相关业务及无形资产、固定资产注入美琪电路。因深圳志金已有20年封装基板研发制造技术积累，但缺乏稳定的资金投入及高效的精益管理体系，其目前的技术团队与封装基板产能与公司目前战略投资方向及半导体投资资源积累较为匹配，后续双方将以优势互补，共同推动封装基板相关业务，以助力公司高质量成长发展，推动公司长期价值提升。</p> <p><b>（二）公司封装基板业务以后的定位目标？</b></p> <p>答：封装基板业务的定位目标是成为公司“三驾马车”战略中的“新质材料增长型业务”核心业务，推动企业从单一建材材料向新质先进材料产业升级转型。</p> <p>建材业务作为“基石业务”提供稳定现金流，而封装基板业务作为公司新质材料增长型业务，公司将通过该业务培育第二成长曲线，突破成熟产业“内卷式”竞争圈，走出以新质生产力实现高质量持续发展的新路径。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026年3月27日

注：若想了解更多公司资讯欢迎您关注“上峰水泥”微信公众平台（sfsn-000672）或公司网站（[www.sfsn.cn](http://www.sfsn.cn)）。  
电话：0571-56030516、56030515，欢迎您与我们互动交流，感谢您的关心与支持。谢谢！